

PLASTIMUL C

Bezrozpuszczalnikowa, zagęszczona emulsja bitumiczna do izolacji przeciwwilgociowych oraz do gruntowania powierzchni przed stosowaniem powłok bitumicznych



ZAKRES STOSOWANIA

Plastimul C jest stosowany po rozcieńczeniu wodą w proporcji 1:10 jako preparat gruntujący pod hydroizolację **Plastimul Fibre Plus** lub **Plastimul 2K Super** oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i powłok ochronnych powierzchni pionowych i poziomych podziemnych elementów konstrukcji betonowych i murowanych, także w budownictwie komunikacyjnym. **Plastimul C** jest nakładany pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Plastimul C jest jednoskładnikową skoncentrowaną emulsją bitumiczną, bezrozpuszczalnikową, produkowaną w oparciu o formułę opracowaną w laboratoriach badawczo-rozwojowych MAPEI.

Plastimul C po rozcieńczeniu wodą może być nakładany pędzlem lub wałkiem; jest odporny na działanie agresywnych substancji występujących w glebie.

Po aplikacji **Plastimul C** szybko wysycha i poprawia przyczepność zastosowanych produktów hydroizolacyjnych z linii **Plastimul**.

Plastimul C można stosować na podłożach suchych lub lekko wilgotnych.

Plastimul C może być stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i powłok ochronnych podziemnych części obiektów inżynierii komunikacyjnej jak: mostów, wiaduktów, tuneli, murów oporowych.

ZALECENIA

- Nie rozcieńczać **Plastimul C** rozpuszczalnikami.
- Nie mieszać **Plastimul C** z cementem lub domieszkami.
- Nie nakładać **Plastimul C** w temperaturze poniżej +5°C i powyżej +30°C.
- Nie nakładać na istniejące warstwy bitumiczne lub na podłoża zawierające smołę.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Przed nałożeniem **Plastimul C** na podłoża murowane należy sprawdzić, czy powierzchnia jest czysta, mocna i równa. Należy usunąć z powierzchni resztki zaprawy murarskiej i uzupełnić ewentualne braki fug szybkowiążącą zaprawą cementową wzmocnioną włóknem **Nivoplan Fast**, zaprawą o skomensowanym skurczu **Mapegrout Tissotropico**, **Mapegrout 450 Thixo**, **Mapegrout 430** lub **Mapegrout T60**, jeśli wymagane jest zastosowanie zaprawy siarczanoodpornej. Alternatywnie, do reprofiliacji podłoża można zastosować zaprawę z cementu, piasku i dodatku emulsji polimerowej **Planicrete**.

W przypadku powierzchni betonowych należy również usunąć wszelkie nierówności w podłożu i gniazda żwirowe. Usunąć mleczko cementowe, kruszące się części oraz wszelkie ślady pyłu, tłuszczu i olejów metodą piaskowania lub wodą pod ciśnieniem.

Do wypełnienia ubytków lub naprawy podłoża należy użyć **Mapegrout Tissotropico**, **Mapegrout 450 Thixo**, **Mapegrout 430** lub **Mapegrout T60**.

W miejscach połączenia fundamentu i muru elewacyjnego, uformować wyoblenia za pomocą **Nivoplan Fast, Planitop 400, Mapegrout Thissotropico** lub **Mapegrout T60**.

Przygotowanie produktu

Plastimul C jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Przed użyciem należy go dokładnie przemieszać.

Gruntowanie podłoża

Plastimul C rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1: 10 (1 część **Plastimul C** na 10 części wody). Rozcieńczony produkt nanosić na uprzednio przygotowane podłoże pędzlem lub wałkiem. Do naniesienia grubowarstwowej izolacji bitumicznej **Plastimul Fibre Plus** bądź **Plastimul 2K Super** można przystąpić gdy warstwa gruntująca osiągnie stan matowo – wilgotny (zwykle po około 1 godzinie w temperaturze +23°C i w wilgotności względnej 50%).

Powłoka ochronno-izolacyjna

Do wykonania powłoki ochronnej i przeciwwilgociowej stosujemy **Plastimul C** nierozcieńczony.

Podłoże zagruntować **Plastimul C** rozcieńczonym w proporcji jak wyżej.

Warstwę izolacji należy nanosić po wyschnięciu warstwy gruntującej najlepiej w dwóch cyklach roboczych, pędzlem lub wałkiem.

Ochrona warstwy izolacji

Przed zasypywaniem wykopów i układaniem płyt ochronnych, warstwa hydroizolacji z materiału **Plastimul C** musi wyschnąć. Czas schnięcia jest uzależniony od temperatury i wilgotności powietrza.

W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza proces schnięcia przebiega wolniej. Do zasypywania wykopów należy używać odpowiednich materiałów.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia można umyć wodą, gdy **Plastimul C** jest jeszcze wilgotny. Gdy stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

Jako zagruntowanie 20 – 30 g/m² koncentratu.

Jako powłoka ochronna ~0,5 kg/m² na dwie warstwy.

OPAKOWANIA

Plastimul C jest dostępny w wiaderkach po 5 lub 30 kg.

PRZECHOWYWANIE

Plastimul C należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie niższej niż +5°C, maksymalnie przez okres 12 miesięcy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

DANE TECHNICZNE (wartości typowe)

DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU

| | |
|---|--------|
| Postać: | pastą |
| Kolor: | czarny |
| Gęstość objętościowa (kg/dm ³): | 1,1 |
| Odczyn pH: | 10 |

Lepkość Brookfielda (mPas)

5 000 (wirnik 4 – 20 obr./min.)

DANE APLIKACJI (w temperaturze +23°C i wilgotności względnej 50%)

Proporcja mieszania (emulsja gruntująca):

Plastimul C:woda = 1:10

Czas schnięcia:

po około 45 – 60 minutach

Stan podłoża

suche lub lekko wilgotne

Temperatura aplikacji:

od +5°C do +30°C

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl

2191-11-2022-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

